

# Adhesive for chip mounting machines

## チップ部品実装機用接着剤

# Seal-glo<sup>®</sup> NE8800& 3000 シリーズ

Seal-glo<sup>®</sup>NEシリーズはチップ部品仮固定用接着剤として開発された接着剤で、1液でありながら保存安定性に優れた加熱硬化型のエポキシ系接着剤です。Seal-glo<sup>®</sup>NEシリーズはSMD実装に求められる120~150℃加熱で1~2分の短時間で高速硬化性を持つのみならず高速ディスペンサーや微細印刷性に優れた各種グレードを備えて皆様のご要望にお応えしております。

“Seal-glo<sup>®</sup> NE series” are a range of adhesives developed for temporary chip-bonding, prior to the wave-soldering process. They are all single component, heat-curing, epoxy adhesives which have excellent preservation qualities. “Seal-glo<sup>®</sup> NE series” not only have rapid curing properties, with a 1~2 minute heating duration between 120~150℃, as required for SMD mounting, but their fine properties enable them to be applied by both high speed dispensing and screen printing alike. We have a wide range and variety of grades to meet specific customer requirements.



### ■特徴 NE8800シリーズ

- ①従来より低い温度での硬化が可能です。
- ②超高速塗布・微量塗布でも糸引き・ダレのない安定した形状を保ちます。
- ③各種チップ部品に対し、安定した接着強度が得られます。
- ④貯蔵安定性に優れています。
- ⑤高い耐熱性と優れた電気特性があります。

### ■特徴 NE3000S

- ①各種チップ部品に対して安定した接着性が得られます。
- ②スクリーン印刷性に優れた粘度とチクソ性を有しているために印刷パターンがダレません。
- ③一液のエポキシ接着剤でありながら保存安定性に優れています。
- ④接着剤のタック性が高いため、高速マウント時の部品ズレがありません。

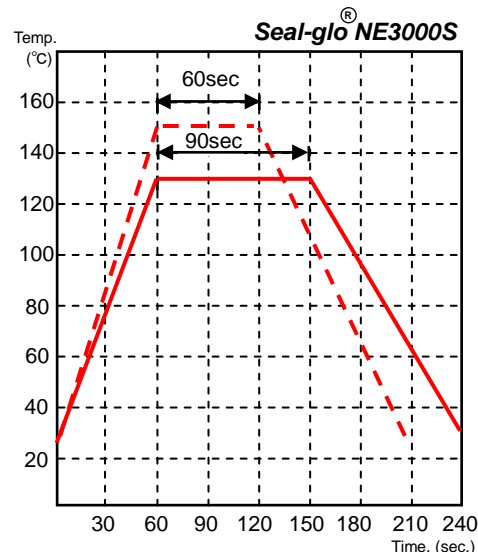
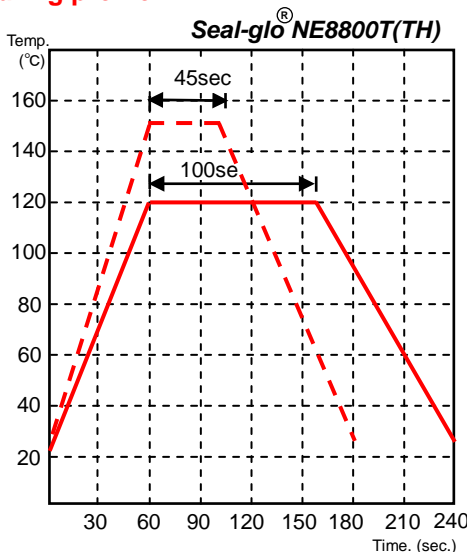
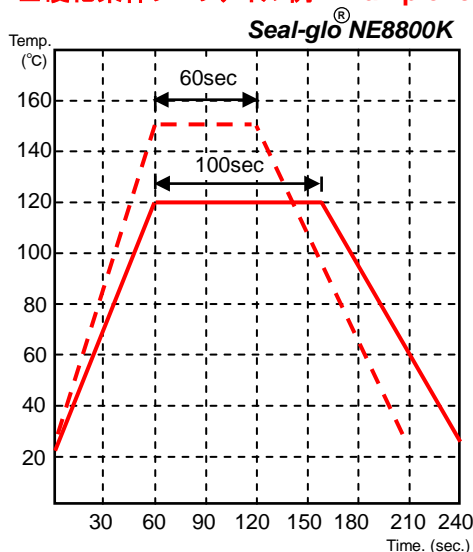
### ■Specifications NE8800 series

- ①Lower temperature curing is now practical and easy to achieve.
- ②Produces stable curing shapes, without stringing or slumping, even when dispensing small dots at ultra high speeds.
- ③Uniform and consistent adhesive strength with all components.
- ④Long-heat preservation stability can be anticipated.
- ⑤Exhibits high-heat resistively and excellent electric properties.

### ■Specifications NE3000S

- ①Uniform and consistent adhesive strength with all components.
- ②Optimum viscosity and an ideal thixotropy ratio for screen-printing, means a perfect and consistent printing pattern, with no spreading.
- ③Convenient, single component adhesives, with excellent stability even after long storage times.
- ④High green strength helps prevent skewing, even at high speed chip mounting speeds.

### ■硬化条件プロファイル例 Example: curing profile



硬化温度が高いほど、また硬化時間が長いほど高い接着強度が得られます。

基板に搭載する部品の大きさ・配置によっては、実際に接着剤にかかる温度が変化する場合がありますので最適な硬化条件を求めてください。

The higher temperature given is and the longer time applied is, the stronger adhesive strength would be obtained.

A suggestion is that an optimum series of curing condition should be searched out, for the temperature exerted on applied adhesive may occasionally vary according to the sizes, the lay-out, etc. of component parts to mount on PCB's.



A adhesive for  
chip mounting  
machines

## ■特性 Specifications

	<i>Seal-glo</i> <sup>®</sup> NE8800K	<i>Seal-glo</i> <sup>®</sup> NE8800T(TH)	<i>Seal-glo</i> <sup>®</sup> NE3000S
塗布方法 Application methods	高速ディスペンサー High-speed dispenser		スクリーン印刷 Screen printing
成分 Composition	エポキシ樹脂 Epoxy resin		
外観 Appearance	赤色ペースト状 Paste/red-colored		
比重 Specific gravity	1.28	1.33	1.38
粘度 Viscosity (25°C・5rpm)	300Pa・S (300,000cps)	310Pa・S (310,000cps)	390Pa・S (390,000cps)
チクソ指数 Thixotropy index	6.8 (1rpm / 10rpm)	6.3 (1rpm / 10rpm)	5.0 (1rpm / 10rpm)
接着強度 2125C Adhesive Strength	44N(4.5kgf)0.2mgr twin	45N(4.6kgf)0.2mgr twin	44N(4.5kgf)0.2mgr twin
ガラス転移点 (T <sub>g</sub> ) Glass transition temperature	115°C	118°C	148°C
誘電率 Dielectric constant 誘電正接 Dissipation factor	3.62/1MHz 0.013/1MHz	3.7/1MHz 0.016/1MHz	3.8/1MHz 0.027/1MHz

※ハロゲン対策品 Halogen free type NE3000S / NE8800TH

## ■包装形態 Package style

包装形態 Package styles	内容量 Contents	包装単位 Pack. Unit	対応ディスペンサーメーカー Applicable Dispenser Makers
カートリッジ Cartridge	200gr	5pcs.	For our filing machines only
A シリンジ A Syringe	30cc	12pcs.	Panasert (HDF), HITACHI, TOSHIBA, SONY CASIO, YAMAHA, JUKI
B シリンジ B Syringe	30cc	12pcs.	FUJI
D シリンジ D Syringe	20cc	12pcs.	Panasert (EFD syringe)
E シリンジ E Syringe	10cc	12pcs.	TOSHIBA, YAMAHA, JUKI, CASIO

※印刷用のNE3000SIにはシリンジ包装はありませんが、ご要望に拠ってはボトル容器も準備できます。  
※"NE3000S" is not available in syringes, but it can be supplied in small bottles on request.

## ■注意事項 Warning

### 保存条件 STORAGE CONDITIONS

2~10°Cの冷蔵庫に保管して下さい。  
保管に際しては、容器の蓋をきっちりと閉めて保管して下さい。  
Refrigerate between 2°C and 10°C.  
When storing, keep all container lids completely closed.

ハロゲンフリー対応品については当社 HP 記載の正規代理店からの購入以外は保証できません。  
Note: We only guarantee our products Halogen-free products if they are purchased from our formal sales distributors and/or representatives. Please check our list at : [www.fujichemi.com](http://www.fujichemi.com)



新素材とエレクトロニクスの融合。  
新しい機能性材料の発掘からエレクトロニクスへの応用まで。  
ファインケミカルにおけるスペシャリティ化を通じて  
富士化学産業は、常に最先端テクノロジーとの係わりを目指し続けます。

Our goal; the fusion of new materials with electronics!  
We at Fuji Chemical Industrial Company never cease  
to examine the possibilities presented by frontier technologies.  
Through specialization in the fine chemical field, we continually  
explore new functional materials and their practical  
development into applications in electronics.